# 通　　知

中華民國 108 年 8 月 29 日

聯絡人：楊弘道組長、何鴻裕專員
電話：2717162 傳真：2717165

一、本案係科技部 109 年度「產學研發聯盟合作計畫-半導體領域試辦計畫」（REAL 計畫），自即日起受理線上申請，依來文須於 108 年 10 月 28 日（星期一）函文抵科技部，擬請有意申請教師於 108 年 10 月 21 日（星期一）晚上 12 時前完成線上申請作業，並於 108 年 10 月 22 日（星期二）中午 12 時前將計畫書第一頁傳送至本處。

二、合作企業需符合科技部「補助產學合作研究計畫作業要點」第二點規定者，應每年現金出資至少新臺幣一百萬元以投入本計畫研發，出資金額應高於向科技部申請補助經費，出資期間並與本計畫之執行重疊一定期間。參與本計畫之博士生每人每月獎學金業界至少投入 2 萬元，科技部至少補助 2 萬元。

三、計畫申請書應檢附「計畫推薦機構審核資料」、「申請人與企業之合作約定書」函送科技部，其中「計畫推薦機構審核資料」須以密封形式函送科技部，科技部將依申請人建議之推薦機構，將「計畫推薦機構審核資料」送推薦機構進行審核；另科技部辦理計畫審查時，得通知申請人到部報告。

四、除前述申請程序外，如申請人與計畫推薦機構取得協議，可由該推薦機構直接受理申請人提出之計畫推薦機構審核資料，並依審核結果出具推薦計畫證明文件後，再另向科技部提出申請書。計畫推薦機構得依本計畫「計畫推薦機構審核資料」之格式規範，包含但不限於科技部格式，設計受理推薦計畫之構想書表；惟於受理推薦申請前，應函報科技部備查。

五、前揭之推薦機構，係指我國與本次徵求領域相關之研發聯盟或產業公協會，其設立運作非以接受政府補助為主，且其宗旨應包括促進產學合作、推動產業前瞻技術研發，須確認計畫內容為業界認可之產業前瞻技術研究，還有與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯性等。

六、本案相關申請詳細資訊請參閱附檔。

七、檢送來文及相關附件如附檔。請各單位轉知所屬知悉。

此致

各學院

研究發展處敬啟